

2023 新加坡惠安公会奖学金申请表格

Singapore Hui Ann Association Scholarship

组别 小学 中学 初院/高中 工艺教育学院 理工学院 大学
Category Primary Sec JC/MI/IP/IB ITE Polytechnic University

申请学生资料 Applicant's Particulars

姓名 (中文) _____ Name (English) _____	年龄 Age _____	性别 Gender _____	近 照 Photo
出生日期/地点 Date/Place of Birth _____	身份证号码 IC No.(最后 3 个数字加上英文字母 Last 3 digits & the alphabet) _____		
住址 Address _____			
电邮 Email _____	电话 Tel _____	手机 HP _____	
2023 就读学校 Name of School/ Institution _____		2023 就读年级 Level _____	
我参加过下列公会的活动 I ever took part in Association's activities shown below: (活动与日期 activities & dates)		我有意参加公会的活动 I intend to take part in the Association's activities <input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No	

家庭成员资料 Family Members' Particulars

家庭成员 Family Members	姓名 Name	年龄 Age	职业 Occupation	公司(可选的)/ 学校名称和年级 Company (optional) / School & Standard attained
父 Father				
母 Mother				
兄弟姐妹 Brother/Sister				

证明人资料 Referee's Particulars

姓名 (中文) _____ Name (English) _____	年龄 Age _____	性别 Gender _____	身份证号码 IC No.(最后 3 个数字加上英文字母 Last 3 digits & the alphabet) _____
职业 Occupation _____ 电话 Tel No. _____(H)	住址 Address. _____		证明人签名 Signature of Referee _____

申请者声明 Applicant's Declaration

我谨此声明所提供资料全部属实。 I declare that all information provided in this application is true and correct.

申请学生签名 Signature of Applicant /日期 Date

家长(会员)签名 Signature of Parent (Member)